

## INVESTOR RELATIONS

2022년 1분기

Your Most trustworthy



## 유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

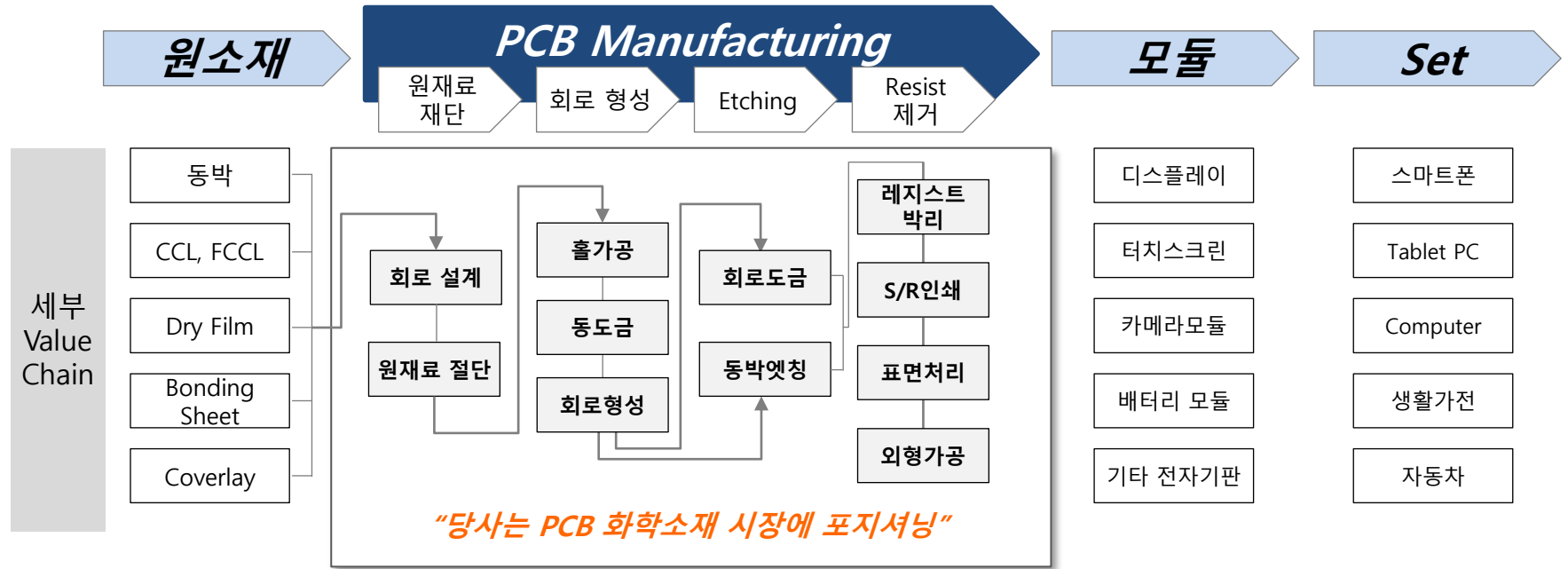
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대 중”  
 End User 또한 기존 스마트폰 제조사에 한정되어 있었으나 전기차, 통신칩 등 첨단 산업으로 확대

FPCB Customer	   
	   
	   
PKG Substrate	   

## Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정/박리제부터 최종표면처리까지, 모든 화학소재 기술을 보유함으로써 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



### Final Finishing Chemical

#### **Soft ENIG Process**

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENEPIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **EPIG process**

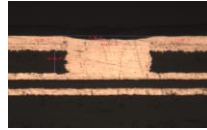
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **Immersion process**

- ✓ PROTIN Series

#### **Electrolytic gold process**

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



### Copper plating chemical

#### **Electroless Copper plating**

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

#### **Electrolytic Copper plating**

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



### Process Chemical

#### **DES Chemical**

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

#### **Cleaner**

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

#### **Gold Recover**

#### **UBM Etchant**

#### **LAZ Process**



### New product for 5G

#### **No etching and roughness laminating pretreatment**

#### **Ultra low profile detachable thin copper foil**

#### **Positive Cu roughening**

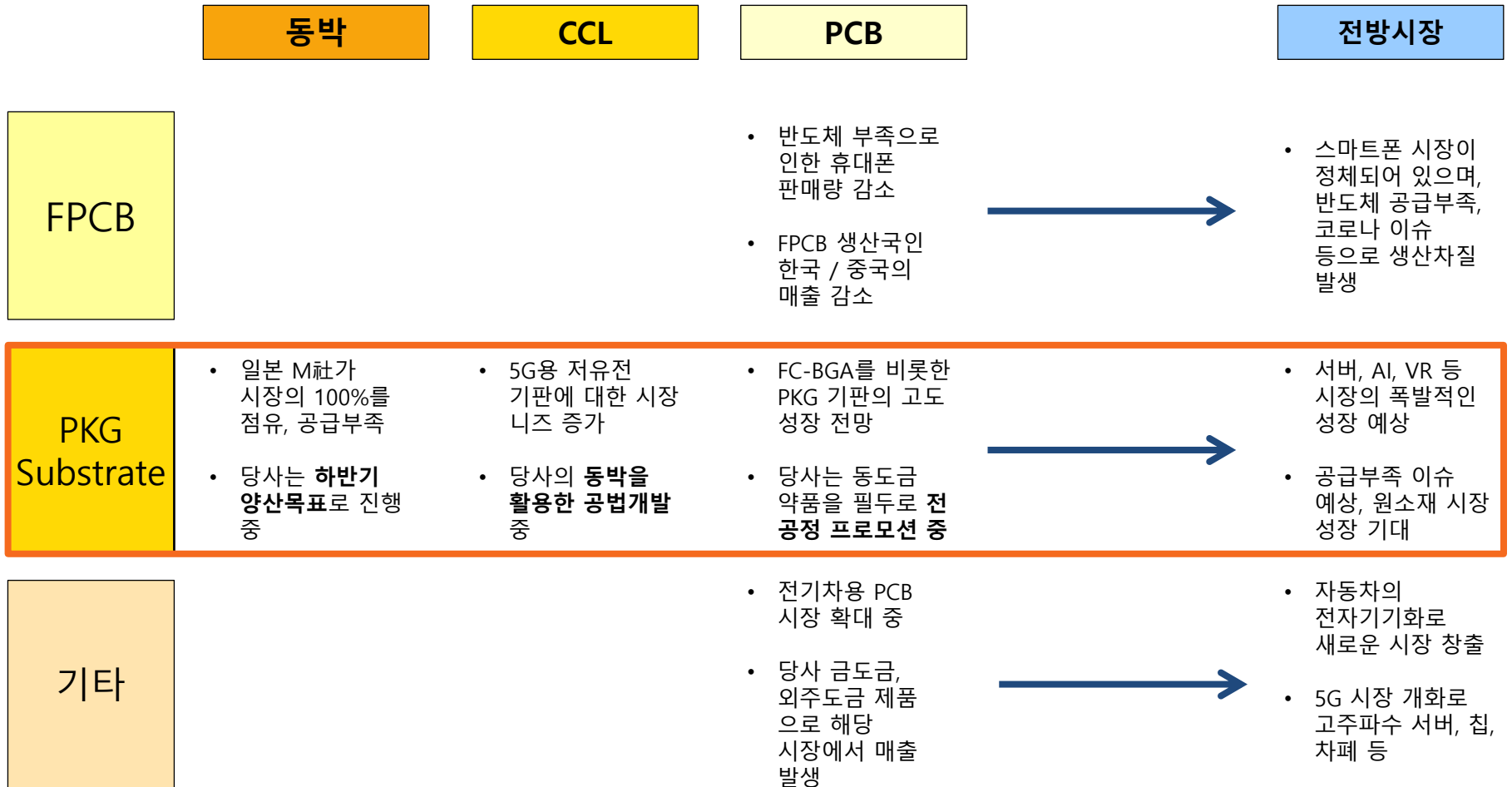
#### **Process Nanotus®**

#### **Electroless Copper plating for LCP**

Domestic Market situation

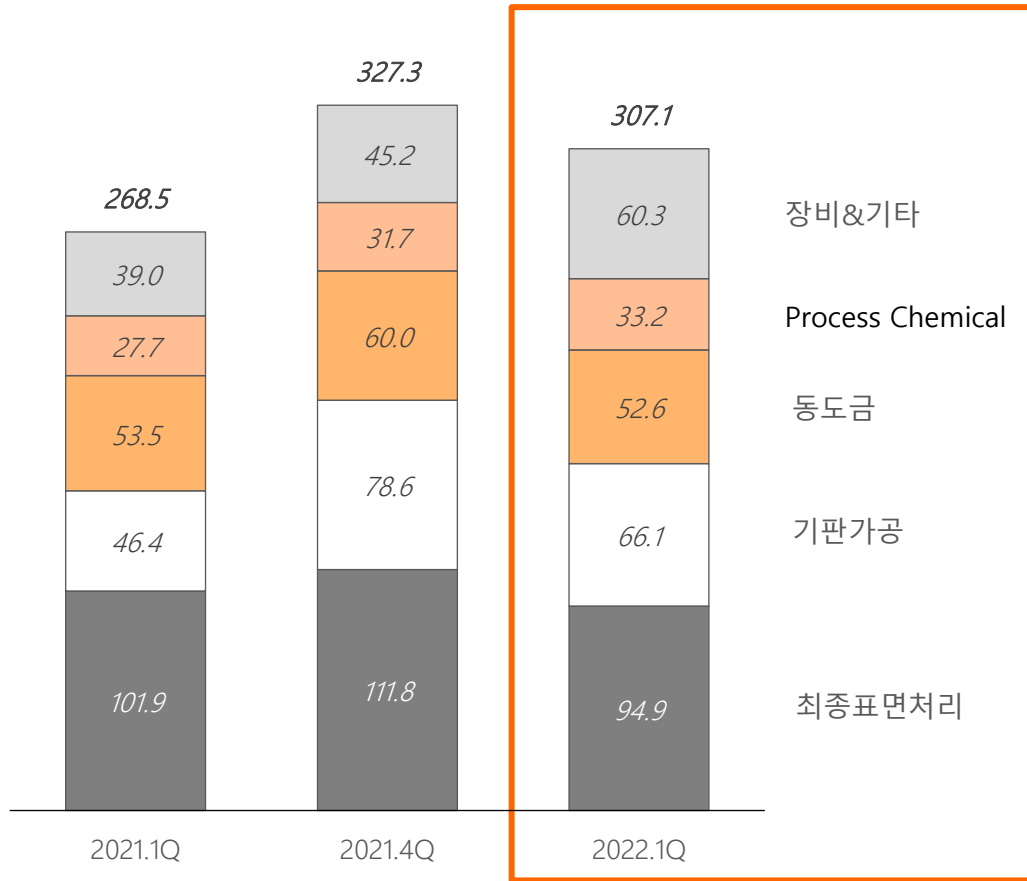
신규 사업분야  
기존 사업분야

		"기존 사업영역" FPCB, RFPCB		"22년 신규진입분야" PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>BH Flex</li> <li>Youngpoong</li> <li>Daeduck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>Daeduck</li> <li>SIMTECH</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daeduck</li> <li>LG Innoteck</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyunwoo</li> <li>SEIL</li> </ul>				
	Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhending Technology</li> <li>Career</li> <li>Unimicron</li> <li>Mektron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Various</li> </ul>				
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> <li>점유율 확대 중</li> <li>Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 및 라인 확대 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>박리 / 에칭 관련 매출 확대중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 높은 수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2분기 고객사 공급 확대 전망</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 HDI 업체 프로모션 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>외주를 통한 양산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 자회사 외주를 통한 매출발생 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 평가 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일부 국내 고객사 거래 중</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>베트남 시장 전해금도금 외주물량 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>				



Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비 (단위: 억원)



• 1분기 역대 최대 매출 달성

- ✓ 21년 1Q 대비 38.6억원 / 14% 성장
- ✓ 단, 팔라듐 가격 상승에 의한 판가 인상, 금(상품)의 공급에 의한 마진을 하락

• Chemical 제품군의 지속적인 성장

- ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 대비 매출 상승

• 베트남 법인의 매출 및 이익 확대

- ✓ 21.1Q 61.4억원 → 22.1Q 76.4억원 / 24.4% 성장
- ✓ 국내 FPCB 고객사의 물량이 베트남으로 이전됨에 따라 베트남 법인의 약품 매출 확대
- ✓ 베트남 법인 도금사업부 기판가공 매출실적 확대

• YPT 매출 및 이익 확대

- ✓ PKG 동도금, 전장시장 진출 등으로 21.1Q 32.4억원 → 22.1Q 43.6억원 / 34.8% 성장



신규사업 진행현황

**소재사업 (동박)**

- 소부장 100 진행 중으로 올해 하반기 PKG Substrate 제조사向 매출 발생 전망
- 기술개발은 완료. 현재 사양산 중으로 최종 End User와 신뢰성 테스트 중
- 현재 보유 Capa로 연간 200억원 수준의 매출 가능 (향후 3년 후 시장규모 약 1조원, 당사 목표 점유율 20%)
- 5G 및 미세회로 공정상 일본의 M사보다 경쟁우위에 있으며, 현재 독점적 지위의 극동박 시장에 한국형 동박을 런칭, 이원화 체계 구축

	두께	용도	Player	전방
동박	1~3 $\mu$ m	PKG Substrate PCB의 mSAP / SAP 공정에 사용	일본 1개사가 100%점유	반도체 시장 향후 2차전지로 확대
	6 $\mu$ m ~	주로 전기차 음극재로 사용	SK넥실리스, 두산, 일진 등	2차전지
	9 $\mu$ m ~12 $\mu$ m	일반 PCB 용 동박	중국 동박 업체	일반전자제품

**B2C용 동박**

- 당사의 원단은 항균성능, 살균성능, 유해물질, 항바이러스 등 모든 시험성적서 획득
- 현재 마스크용 원단으로 판매 중이며, 골프회사와 협업을 진행 중에 있음
- 금속봉대 시장이 성장, 당사 기술 적용 가능한 특수창상피복재료로 현재 대학병원과 공동 프로젝트 중

Income Statement

(단위:억원)

	2022.1Q	매출비중	2021.1Q	매출비중
I. 매출액	307.1	100%	268.5	100%
II. 매출원가	223.2	72.7%	186.4	69.4%
III. 매출총이익	83.9	27.3%	82.1	30.6%
판매비와 관리비	74.6	24.3%	36.0	13.4%
IV. 영업이익	9.3	3.0%	46.1	17.2%
금융수익	15.4	5.0%	20.2	7.5%
금융비용	11.9	3.9%	5.5	2.0%
기타수익	0.9	0.3%	1.3	0.5%
기타비용	1.4	0.4%	0.1	0.0%
지분법손익	-	-	-	-
V. 법인세차감전순이익	12.3	4.0%	62.0	23.1%
법인세비용	13.9	4.5%	14.2	5.3%
VI. 당기순이익	(1.6)	-0.5%	47.8	17.8%

주요 수익성 지표

	2022.1Q	2021.1Q
영업이익률	3.0%	17.2%
순이익률	-0.5%	17.8%
EBIT	27.0	62.1
EBITDA (마진율)	8.80%	23.15%
ROE	-0.6%	3.6%
총자산회전률	12.4%	13.4%

- ✓ 키미랩 광고비와 소재사업(동박) 사양산으로 1분기 40억원 이상의 일시적 지출 증가
- ✓ 원자재 가격 상승으로 인한 원가상승, 코로나 및 반도체 공급부족으로 인한 매출 하락이 실적 악화의 원인
- ✓ 단, 기존 사업부 실적의 견조함에 근거, 일회성 비용 및 초기 양산비용 인식에 따른 일시적 이익률 훼손은 회복될 것으로 전망

Balance Sheet

(단위:억원)

	2022.1Q	2021
자산		
현금성자산	534.3	701.9
매출채권	227.6	260.9
재고자산	223.0	190.5
유형자산	1,027.7	955.3
기타자산	468.5	354.0
<b>자산총계</b>	<b>2,481.1</b>	<b>2,462.6</b>
부채		
매입채무	52.4	36.9
차입금	679.8	682.5
전환사채	88.2	95.2
기타부채	252.8	254.4
<b>부채총계</b>	<b>1,073.2</b>	<b>1,069.0</b>
자본		
자본금	75.5	74.8
자본잉여금	262.3	249.4
기타자본	47.7	38.9
이익잉여금	750.9	768.9
비지배지분	271.5	261.6
<b>자본총계</b>	<b>1,407.9</b>	<b>1,393.6</b>
부채와 자본총계	2,481.1	2,462.6

Cash Flow

(단위:억원)

	2022.1Q	2021.1Q
기초현금	701.9	556.4
영업활동으로 인한 현금흐름	39.0	25.9
당기순이익	(1.6)	47.8
감가상각비	15.5	13.3
이자비용	6.8	5.3
기타	18.3	(40.5)
투자활동으로 인한 현금흐름	(208.8)	(8.0)
유형자산의 처분(취득)	(87.1)	(11.3)
금융상품의 감소(증가)	(28.5)	2.9
대여금의 감소(증가)	(94.0)	(0.1)
기타	0.8	0.5
재무활동으로 인한 현금흐름	(5.0)	(7.6)
차입금의 증가(감소)	(2.7)	(5.7)
기타	(2.3)	(1.9)
현금증감	(174.8)	10.3
환율 변동 효과	7.2	17.8
기말현금	534.3	584.5